



# 2026 年第 5 屆美國矽谷國際發明展

## 邀 請 函

發明先進：敬啟

美國是我國最大的貿易市場，每當有新產品問市，莫不以進入美國市場為第一考量，今年美國 SVIIF 即將在八月開展，本會將組團參加，盼有新產品之發明人或廠商，欲獲取美國市場者，美國矽谷國際發明展將是一項最佳選擇，想藉由參加此大展吸取經驗者，千萬不要錯失這一年一度的發明展出盛會。

往年美國發明展展出時，全球各地工商人士都前往參觀，各國新聞媒體均前往採訪報導，您有可能一夕之間舉世聞名，又可觀摩世界各國發明家的新作品以予學習改進參考，一舉數得。

今年我們除了傳承以往的優點外，本屆展覽預計有廿餘國參展，敬盼與您同行。

**2026 年 SVIIF 於 8 月 14 日~16 日開展**

**假聖克拉拉會議中心舉行**

**即日起接受報名至 5 月 30 日截止**



台灣發明協會  
美國矽谷參展團

團長 **張家菊** 敬邀

# Silicon Valley International Invention Festival 2026 美國矽谷國際發明展-參展辦法

- 一、宗旨：為宣揚我國工業技術能力、促進國際科技交流、爭取國家榮譽、增進國民外交、拓展發明新產品海外市場及提高新產品之行銷市場價值。
- 二、主辦單位：國際發明聯盟總會(IFIA)
- 三、台灣授權單位：台灣發明協會
- 四、團名：2026 美國矽谷國際發明展-台灣參展團
- 五、依據：美國矽谷國際發明展大會組團授權書
- 六、展覽會名稱：Silicon Valley International Invention Festival 2026
- 七、展出日期：2026 年 8 月 14 日~8 月 16 日
- 八、展出地點：USA, California, Santa Clara Convention Center

5001 Great America Pkwy, Santa Clara, California 95054, United States

## 九、費用：

1. 參展費：每件作品**\$60,000 元**。  
(包含報名費、展位費、評審費、入場證、1 桌 2 椅及電源費)。
2. 海報費：每件**\$1,000 元**(自理者免繳)。
3. 代展費：每件**\$10,000 元**。  
(代展作品需提供 3 分鐘內影片，請上傳 YouTube 後提供網址。)
4. 個人旅費：預估 14 萬左右。欲隨團者，請提供隨團報名表及護照影本，後續由旅行社聯繫。如未達成團人數，將改為自行前往。
5. 作品攤位由協會安排，如需獨立攤位則需另加攤位費**\$30,000 元**。
6. 現場中英翻譯人員 160 美元/日(請自行交付翻譯人員，本會不代收。)

## 十、即日起接受報名至 2026 年 5 月 30 日截止。

※ 截止日前資料未繳交齊全者將無法刊登於矽谷展覽大會專刊。

※ 指定轉角攤位者須另加台幣 10,000 元。(有預訂並繳款者優先)

攤位示意圖：



## 繳交參展資料明細單：

請以電子檔交件：tia7626@yahoo.com.tw

寄件主旨請輸入□□□(個人名、學校名或公司名)報名美展。

文字部分請交 **word** 檔，照片圖檔請以 **jpg** 檔交件，每件作品請獨自建立一個資料夾，報名一件以上之作品，請於資料夾上輸入編號，以便雙方核對或通知補件，謝謝。

- ☐1. 已填妥之報名表(一件作品填寫一份報名表，需詳細填寫完整)  
含產品介紹中、英文(約 150 字左右)
- ☐2. 參展切結書(請由該件作品一位發明人代表簽名或蓋章)
- ☐3. 參展品專利證書檔案或申請中收據(無專利者免附)
- ☐4. 參展品照片檔案(每件作品建議提供二張)
- ☐5. 隨團前往參展人員請附上隨團參展表(含護照影本)
- ☐6. 自行前往參展人員請提供人數及中英文姓名
- ☐7. 發明人或聯絡人名片
- ☐8. 聘請翻譯人員切結書(無聘請者免填)

報名日期：即日起接受報名至 5 月 30 日截止

聯絡地址：(241-608)新北市三重區重陽路一段 1 號 4 樓之 11

聯絡人：秘書處 吳秋瑾 小姐

聯絡電話：02-6605-7626

E-mail：tia7626@yahoo.com.tw

- 參展資料請連同全額參展費於報名截止日前繳交至本會，以完成報名手續。  
(以上資料未齊全或未繳付全額參展費者，歉難受理報名。)
- 電匯資料：新光銀行(銀行代碼 103) 北三重分行  
戶名：“**社團法人台灣發明協會**”。 帳號：“**0310-10-100304-3**”。

**@tia1972**



台灣發明協會  
官方好友 LINE